

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-009

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
- 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现营业收入359,500.00万元左右，同比增长约16.26%。预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损12,100.00万元左右，同比减亏约54.47%。
- 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损16,100.00万元左右，同比减亏约39.46%。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

#### （二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入359,500.00万元左右，与上年同期相比增加50,268.34万元左右，同比增长约16.26%。其中实现主营收入355,600.00万元左右，同比增长约16.08%。

2、预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损12,100.00万元左右，与上年同期相比，亏损将减少14,475.71万元左右，同比减亏约54.47%。

3、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损16,100.00万元左右，与

上年同期相比，亏损将减少10,495.86万元左右，同比减亏约39.46%。

4、预计2025年年度实现EBITDA（息税折旧摊销前利润）112,000.00万元左右，与上年同期相比增加48,330.17万元左右，同比增长约75.91%。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

## 二、上年同期业绩情况

1、营业收入：309,231.66万元。

2、归属于上市公司股东的净利润：-26,575.71万元。

3、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-26,595.86万元。

4、EBITDA（息税折旧摊销前利润）：63,669.83万元。

5、每股收益：-0.39元/股。

## 三、本期业绩变动的主要原因

### （一）主营业务影响

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因：

1、随着公司扩产项目陆续转产，本报告期折旧摊销支出约112,370.00万元，同比增加约18,463.00万元。

2、基于谨慎性原则，本报告期计提了约12,560.00万元的存货跌价准备。

3、报告期内公司计提了13,540.00万元的可转债利息费用。

4、2024年12月控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司收购金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司少数股权导致利润减少约4,310.00万元。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏，主要得益于半导体硅片板块盈利能力的复苏。随着产品结构持续向高端化迭代升级，半导体硅片业务的平均销售单价自2025年第一季度起呈现逐季提升态势；加之产销规模的稳步扩张，尤其是12英寸硅片产销量实现大幅增长，硅片单位成本亦随之同步下降。在出货价格提升和单位成本下降的双重驱动下，硅片业务（含对立昂微母公司的销售）的综合毛利率从2024年度的4.72%上升至2025年度的约9%。其中，12英寸硅片的负毛利率状况得到显著改善，由2024年度的-70.68%收窄至2025年度的约-27%；受此影响，硅片业务特别是12英寸硅片的存货跌价准备计提金额也大幅缩减。

报告期内，得益于半导体行业景气度的持续复苏，下游客户需求增长及公司加强市场拓展、优化产品结构等因素的影响，公司主要产品产销量变动如下：（1）半导体硅片（出货面积折合为6英寸）的销量约1,939.41万片（含对立昂微母公司的销量248.16万片），同比增长约28.20%，其中：12英寸硅片销量约178.57万片（折合6英寸约714.29万片），同比增长约61.90%。（2）半导体功率器件芯片销量约194.42万片，同比增长约6.69%，其中：FRD芯片销量约22.68万片，同比增长约87.04%。（3）化合物半导体射频及光电芯片销量约4万片，同比增长约0.7%，产品结构实现优化，高端应用领域的显著增长为整体业务注入了新的活力。其中：VCSEL芯片销量约0.27万片，同比增长约656.82%；pHEMT、BiHEMT芯片销量约0.23万片，同比增长约26.12%；HBT芯片销量约2.99万片，同比下降约6.30%。

报告期内，受益于市场需求的增长，公司预计实现主营收入约355,600.00万元，同比增长约16.08%，其中：（1）半导体硅片业务凭借公司在重掺领域的技术领先优势和12英寸轻掺产品的技术突破，预计实现主营收入约267,867.85万元（含对立昂微母公司的29,413.55万元），同比增长约19.66%，其中：12英寸硅片实现收入约85,937.36万元，同比增长约65.63%。（2）半导体功率器件芯片业务预计实现主营收入84,386.52万元，同比下降约2.16%，其中：FRD芯片实现收入约17,841.78万元，同比增长约96.18%。（3）化合物半导体射频及光电芯片业务预计实现主营收入约32,744.47万元，同比增长约10.84%，其中：VCSEL芯片实现收入约4,635.38万元，同比增长约723.30%；pHEMT、BiHEMT芯片实现收入约4,194.60万元，同比增长约18.75%；HBT芯片实现收入约19,023.67万元，同比下降约3.63%。

## （二）非经常性损益的影响

本报告期内，公司非经常性损益大幅增加，归属于上市公司股东的非经常性损益同比增加约3,995万元，主要系报告期内公司持有的上市公司股票股价上涨产生公允价值变动收益及处置部分上市公司股票产生的投资收益增加所致。

## 四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，敬请广大投资者注意业绩亏损风

险。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026年1月22日